

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(51) Int. Cl. ⁴	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 23/50			H 0 1 L 23/50	U
				A
21/60	3 1 1		21/60	3 1 1 R

(21) 出願番号 特願平7-47919
(22) 出願日 平成7年(1995)2月14日

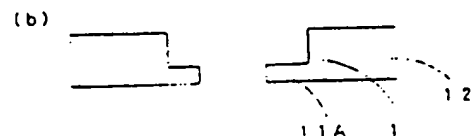
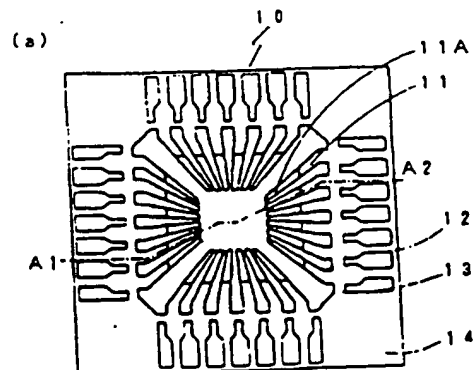
(71) 出願人 000002897
大日本印刷株式会社
東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
(72) 発明者 山田 淳一
東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
大日本印刷株式会社内
(72) 発明者 上 智江
東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
大日本印刷株式会社内
(72) 発明者 佐々木 賢
東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
大日本印刷株式会社内
(74) 代理人 弁理士 小西 淳美

(54) 【発明の名称】 リードフレームおよびその製造方法

(57) 【要約】

【目的】 半導体装置の多端子化に対応でき、且つ、アセンブリ工程や実装工程等の後工程にも対応できる高精細なリードフレームを提供する。

【構成】 半導体素子をバンプを介してインナーリード先端部に搭載し、インナーリードと一体となって延設したアウターリードにより半導体素子と外部回路とを電気的に接続する。樹脂封止型半導体装置用リードフレームであって、インナーリード先端部は、板厚がリードフレームの他の部分の板厚よりも薄く、断面形状が略方形であり、且つ、該インナーリード先端部の1面はリードフレームの他の部分の面に平行で、前記インナーリードの他の3面は凹状に形成されている。



【請求項1】 半導体素子をパッケージ作してインナーリード先端部に搭載し、インナーリードと一体となって延設したアウターリードにより半導体素子と外部回路とを電気的に接続する、樹脂封止型半導体装置用リードフレームであって、インナーリード先端部は、板厚がリードフレームの他の部分の板厚よりも薄く、断面形状が略方形であり、且つ、該インナーリード先端部の1面はリードフレームの他の部分の面に平行で、前記インナーリードの他の3面は凹状に形成されていることを特徴とするリードフレーム。

(A) リードフレーム素材の内面に感光性レジストを塗布する工程。

(B) 前記リードフレーム素材に対し、一方の面は、少なくとも半導体素子をパワジを介して搭載するインナーリード先端部形成領域において平坦状に腐蝕するためのパターンが形成されたパターン版にて、他方の面は、インナーリード先端部形状を形成するためのパターンが形成されたパターン版にて、それぞれ、感光性レジストを露光して、所定形状の開口部を持つレジストパターンを形成する工程。

(C) 少なくとも、インサーリード先端部形状を形成する工程。所定形状の間口部をもつレジストパターンが形成された面から腐蝕液による第一のエッチング加工を行い、腐蝕されたインサーリード先端部形成領域において、所定量だけエッチング加工して止める工程。

(1) インナーリード先端部形状を形成するためのパターンが形成された面側の腐蝕された部分に、耐エッチング性のあるエッチング抵抗膜を埋め込む工程。

(E) 平坦状に熔融するためのパターンが形成された面側から、熔融液による第三のエッチング加工を行い、貫通させる。インサレータと銅線を形成する工程。

(下)上記エポキシ樹脂液、トリスノ膜を剥離し、洗浄する工程、を含むことを特徴とするリードフレームの製造方法。

【註釋】(1) 指《論衡》而言。

(. . .)

【例 7.1】(1992·B) 下列各句中，没有语病的一句是 ()

介してインナーリード先端部に搭載するための樹脂封止型半導体装置用リードフレームとその製造方法に関する。特に、フリップチップ法により半導体素子をインナーリード先端部に搭載するためのリードフレームに関する。

{0002}

【従来の技術】従来より用いられている樹脂封止型の半導体装置（プラスチックリードフレームパッケージ）は、一般に図6（a）に示されるような構造であり、半導体装置60は、半導体素子を42%ニッケル-鉄合金等からなるリードフレームに搭載した後に、樹脂らうに樹脂封止部61を形成して、半導体素子62の電極パッドらうに対応する数のインナーリードらうを必要とするものである。そして、半導体素子61を搭載するダイパッド部62や周囲の回路との電氣的接続を行うためのアウターリード部64、アウターリード部64に一体となったインナーリード部63、該インナーリード部63の先端部と半導体素子61の電極パッドらうとを電氣的に接続するためのワイヤ67、半導体素子61を封止して外界からの応力、汚染から守る樹脂らう等からなっている。このようなリードフレームを利用した樹脂封止型の半導体装置（プラスチックリードフレームパッケージ）においても、電子機器の軽薄短小化の時流と半導体素子の高集積化に伴い、小型薄型化かつ電極素子の増大化が顕著で、その結果、樹脂封止型半導体装置、特にQFP（Quad Flat Packag

e) 及び TQFP (Thin Quad Flat Pack) 等では、リードの多ピン化が著しくなってきた。上記の半導体装置に用いられるリードフレームは、微細なものではフォトリソグラフィ技術を用いたエッチング加工方法により作製され、微細でないものはプレスによる加工方法による作製されるのが一般的であったが、このような半導体装置の多ピン化に伴い、リードフレームにおいても、インサーリード部先端の微細化が進み、微細なものに対しては、プレスによる打ち抜き加工によらず、リードフレーム部材の板厚が 0.25 mm 程度のもを用い、エッチング加工で対応してきた。このエッチング加工方法の上行について以下、図 5 に基づいて簡単に述べておく。まず、銅合金もしくは 4-2% ニッケル-鉄合金からなる厚さ 0.25 mm 程度の薄板

(リードフレーム素材 51) を十分洗浄 (図5 (ii)) した後、重クロム酸カリウムを感光材とした水溶性カゼインレジスト等のフォトレジスト 52 を該基板の両表面に均一に塗布する。(図5 (i))

次に、所定のパターンが形成されたマスクを介して高圧水銀灯でレジスト上部を露光した後、所定の現像液で該感光性レジストを現像して（図5（c））、レジストパターン（レジスト）を形成し、硬膜処理、洗浄処理等を必要に応じて行う。第1層レジスト形成工程は同様に繰り返される。

1962-1963

51)に吹き付け所定の寸法形状にエッチングし、乾燥させる。(図5(d))

次いで、レジスト膜を剥離処理し(図5(e))、洗浄後、所望のリードフレームを得て、エッチング加工工程を終了する。このように、エッチング加工等によって作製されたリードフレームは、更に、所定のエリアに銀メッキ等が施される。次いで、洗浄、乾燥等の処理を経て、インナーリード部を固定用の接着剤付きポリイミドテープにてテーピング処理したり、必要に応じて所定の量タブ吊りバーを曲げ加工し、ダイパッド部をダウンセットする処理を行う。しかし、エッチング加工方法においては、エッチング液がエッチング面からエッチング面の他に側面(面)方向にも進むため、その微細化加工にも限度があるのが一般的で、図5に示すように、リードフレーム素材の両面からエッチングするため、ラインアンドスペース形状の場合、ライン間隔の加工限度幅は、板厚の50~100%程度とされている。又、リードフレームの後工程等のアウターリードの強度を考えた場合、一般的には、その板厚は約0.125mm以上必要とされている。このため、図4に示すようなエッチング加工方法の場合、リードフレームの板厚を0.15mm~0.125mm程度まで薄くすることにより、ワイヤボンディングのための平坦幅が少なくとも70~80μm必要であることより、0.165mmピッチ程度の微細なインナーリード部先端のエッチングによる加工を達成してきたが、これが限度とされていた。

【0003】しかしながら、近年、樹脂封止型半導体装置は、小パッケージでは、電極端子であるインナーリードのピッチが0.165mmピッチを経て、既に0.15~0.13mmピッチまでの狭ピッチ化要求がでてきた事と、エッチング加工において、リード部材の板厚を薄した場合、アセンブリ工程や実装工程といった後工程におけるアウターリードの強度確保が難しいという点から、単にリード部材の板厚を薄くしてエッチング加工を行う方法にも限界が出てきた。

【0004】これに対応する方法として、アウターリードの強度を確保したまま微細化を行う方法で、インナーリード部分をハーフエッチングもしくはプレスにより薄くしてエッチング加工を行う方法が提案されている。しかし、プレスにより薄くしてエッチング加工をおこなう場合には、後工程においての精度が不足する(例えば、めっきエリアの平滑性)、ボンディング、モールドイング時のクラックに必要なインナーリードの平坦性、寸法精度が確保されない、製版を2度行なわなければならない等製造工程が複雑になる、等問題点が多岐である。そして、インナーリード部分をハーフエッチングにより薄くしてエッチング加工を行う方法の場合にも、製版を2度行なわなければならない等製造工程が複雑になるという問題点がある。従って、実用化には、このような問題点を克服した

【0005】一方、樹脂封止型半導体装置の多端子化に対応すべく、上記のリードフレームを用いて半導体素子の端子部とリードフレームのインナーリード先端部とをワイヤボンディングする方法とは異なる、半導体素子をバンパを介して外部回路と接続するための導体上に搭載するフリップチップ法が提案されている。この方法は、一般には図7に示すように、セラミック材料よりなる基板73上に配線(インナーリード)72を配し、その配線(インナーリード)72の電極部(インナーリード先端部)72A上に半導体素子70をバンパ71を介して搭載するものである。しかしながら、この方法の場合、配線72の電極部72Aと半導体素子70の電極部72Aとを組み合わせる時にバンパ71が電極部72Aよりズレてしまい、電氣的接続がうまくいかないという問題点があり、このフリップチップ法により、リードフレームのインナーリード先端部に半導体素子を搭載した、樹脂封止型半導体装置も考えられたが、特に高精細なリードフレームを用いたものは実用に至っていない。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】このように、樹脂封止型半導体装置の多端子化に対応でき、且つ、アセンブリ工程や実装工程等の後工程にも対応できるリードフレームが求められていた。本発明は、このような状況のもと、半導体装置の多端子化に対応でき、且つ、後工程にも対応できる高精細なリードフレームを提供しようとするものであり、又、そのような高精細なリードフレームの製造方法を提供しようとするものである。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明のリードフレームは、半導体素子をバンパを介してインナーリード先端部に搭載し、インナーリードと一体となって延設したアウターリードにより半導体素子と外部回路とを電氣的に接続する、樹脂封止型半導体装置用リードフレームであって、インナーリード先端部は、板厚がリードフレームの他の部分の板厚よりも薄く、断面形状が略方形であり、且つ、該インナーリード先端部の1面はリードフレームの他の部分の面に平行で、前記インナーリードの他の3面は凹状に形成されていることを特徴とするものである。また、本発明のリードフレームの製造方法は、半導体素子をバンパを介してインナーリード先端部に搭載し、インナーリードと一体となって延設したアウターリードにより半導体素子と外部回路とを電氣的に接続する、樹脂封止型半導体装置用リードフレームであって、半導体素子をバンパを介して搭載するインナーリード先端部は、樹脂封止型半導体装置用リードフレームの他の部分の板厚よりも薄く、断面形状が略方形であり、前記インナーリード先端部の1面は、インナーリードの他の部分の面に平行で、前記インナーリードの他の3面は凹状に形成されていることを特徴とするものである。本発明のリードフレームを用いてエッチング加工する

【０００８】本発明のリードフレームの製造方法は、半導体装置の多端化に対応したエッチングプロセスによる加工方法であり、第一のエッチング加工により、少なくとも、インナーリード先端部形状を形成するための所定形状の開閉部をもつレジストパターンが形成された面側の腐蝕されたインナーリード先端部形成領域に、インナーリード先端部の（平面的な意味での）外形形状を実質的に形成してしまうものである。したがって、第一のエッチング加工において、所定量だけエッチング加工して止めるとは、インナーリード先端部の外形形状を実質的に形成できる量のエッチング加工でとめるという意味である。そして、第二のエッチング加工により腐蝕形成された、インナーリード先端部形状を形成するためのレジストパターンが形成された面側の腐蝕された部分に、腐蝕防止性のあるエッチング抵抗層を埋め込むことにより、第一のエッチング工程によって形成されているインナーリード先端部形状を保持させる。また形状に腐蝕防止のためのレジストパターンが形成された面側の腐蝕防止層を第一のエッチング加工で除去する。インナーリード先端部

【実施例】本発明のワイヤフレームの製造方法を図に示して説明する。図1は本実施例ワイヤフレームの平面図、図2(a)～(c)は図1(a)～(c)における断面図で、図2(a)～(c)および図2(d)～(f)は該物体表面を格納した場合の平面図、断面図を示す。図1(a)～(c)は、ワイヤフレームの平面図、図2(a)～(c)は、ワイヤフレームの断面図、図2(d)～(f)は、ワイヤフレームの平面図、図2(g)～(i)は、ワイヤフレームの断面図を示す。

中、10はリードフレーム、11はインナーリード、11Aはインナーリード先端部、12はアウトーリード、13はダムバー、14はフレーム部を示している。本実施例のリードフレームは、図1(a)に示すように、半導体素子をバンプを介して搭載するための基面のインナーリード先端部11Aを有するインナーリード11と、該インナーリード11と一体となって連結された外部回路と接続するためのアウトーリード12、樹脂封止の際の樹脂の流出を防ぐためのダムバー13等を有するもので、42%ニッケル-鉄合金を素材とした、一体ものである。インナーリード先端部11Aの厚さは40 μ m、インナーリード幅が1.1mm、外部リード幅は0.7mmである。強度的には後工程に充分耐えるものとなっている。インナーリードピッチは0.12mmと、図6(a)に示す半導体装置に用いられている従来のワイヤボンディングを用いた多ピン(小ピッチ)のリードフレームと比べて、狭いピッチである。本実施例のリードフレームのインナーリード先端部11Aは、断面が図2(c)、図2(d)に示すように、半導体素子搭載面と半導体素子搭載面を挟む両側の面を凹状に形成している。半導体素子搭載面が凹状であることによりバンプ部がインナーリード先端部11Aの面内に乗り易く、位置ズレが発生してもバンプと先端面が接し易い形状である。インナーリード先端部11Aの上面を凹状にしていることにより、機械的にも強いものとしている。

【0011】本実施例のリードフレームを用いた樹脂封止型の半導体装置の作製には、半導体素子の端子部との接続にワイヤボンディングを行わず、ハンパによる接続を行うものであるが、樹脂の封止、タムパーの切除等の処理は、基本的に通常のリードフレームを用いてワイヤボンディング接続を施した半導体装置と同じ処理で行うことができる。図6(b)は、本実施例のリードフレームを用いた樹脂封止型半導体装置の概略構成を示した断面図である。

【0012】本発明のリードフレームの製造方法の実施例を以下、図にそって説明する。図1は本発明の実施例リードフレームの製造方法を示すための、半導体素子をリソングを介して搭載するリソナーリード先端部を含む要部における各工程断面図であり、ここで作製されるリードフレームを示す平面図である。図3(a)のC1-C2部の断面図についての製造工程図である。図1中、41はリソナーリード基材、42A、42Bはレジストパターン、43は第一の開口部、44は第二の開口部、45は第一の凹部、46は第二の凹部、47は平坦表面、48はエッチング抵抗膜、49はインナーリード先端部を示す。まず、42Aのエッチング抵抗膜を形成し、厚みが0.15mmのリソナーリード基材41の両面に、重クロム酸カリウムを感光剤とした水溶性ポリイミドレジストを塗布した後、光透過パターン膜を用いて、所定開口部、第一の開口部43、第二の開口部44を形成し、その

ターン42A、42Bを形成した。(図4(a))
第一の開口部43は、後のエッチング加工においてリー
ドフレーム素材41をこの開口部からベタ状に腐蝕する
ためのもので、レジストの第二の開口部44は、リー
ドフレームの半導体素子をバンプを介して搭載するイン
ナーリード先端部の形状を形成するためのものである。第
一の開口部43は、少なくともリードフレーム41のイン
ナーリード先端部形成領域を含むが、後工程において、
デビングの工程や、リードフレームを固定するクラン
プ工程で、ベタ状に腐蝕され部分的に薄くなった部分と
の段差が邪魔になる場合があるので、エッチングを行う
エリアはインナーリード先端部は詳細加工が不要で、す
べきめにとる必要がある。次いで、温度57℃、濃度
4.8B₂O₃の塩化第二酸素溶液を用いて、スプレー圧2
5k g/cm²にて、レジストパターンが形成されたリ
ードフレーム素材41の両面をエッチングし、ベタ状
(平坦状)に腐蝕された第一の凹部45の深さがリー
ドフレーム部材の1/3に達した時点でエッチングを止
めた。(図4(b))

この段階で、図4（イ）に示すインナーリード先端部49部の（平面的な意味での）外形形状が実質的に作られている。上記第1回目のエッチングにおいては、リードフレーム素材41の両面から同時にエッチングを行ったが、必ずしも両面から同時にエッチングする必要はない。少なくとも、インナーリード先端部形状を形成するための、所定形状の開閉部をもつレジストパターン42Bが形成された面側から腐蝕液によるエッチング加工を行い、腐蝕されたインナーリード先端部形成領域において、所定量エッチング加工し止めることができれば良い。本実施例のように、第1回目のエッチングにおいてリードフレーム素材41の両面から同時にエッチングする理由は、両面からエッチングすることにより、後述する第2回目のエッチング時間を短縮するためで、レジストパターン42B側からのみの片面エッチングの場合と比べ、第1回目エッチングと第2回目エッチングのトータル時間が短縮される。次いで、第二の開閉部44側の腐蝕された第二の凹部46にエッチング抵抗膜48としての耐エッチング性のあるホットメルト型ワックス（サ・インクテエック社製の酸ワックス、型番MBE-WB16）を、ダイコータを用いて、塗布し、ベタ状（平貝状）に腐蝕された第二の凹部46に押め込んだ。レジストパターン42B上にも該エッチング抵抗膜48に塗布された状態とした。（図4（ロ））

エッチング抵抗膜12を、レジストパターン1211の全面に塗布する必要はない。第二の凹部1212を含む一部にのみ塗布することは好ましい。図1(一)に示すように、第二の凹部1212を有する、第二の凹部1211側面面にエッチング抵抗膜12を塗布した実施例の使用したエッチング抵抗膜12は、アルカリ、強酸、有機溶剤を含む。具体的には、エッチング液、有機溶剤、

ング時にある程度の柔軟性のあるものが、好ましく、特に、上記ワックスに限定されず、UV硬化型のものでも良い。このようにエッチング抵抗層48をインナーリード先端部の形状を形成するためのパターンが形成された面側の腐蝕された第二凹部46に埋め込むことにより、後工程でのエッチング時に第二凹部46が腐蝕されて大きくならないようにしてるとともに、高精細なエッチング加工に対しての機械的な強度補強をしておき、スプレー圧を高く(2.5 kg/cm²)とすることができ、これによりエッチングが深さ方向に進行しやすくなる。その後、へく状(平坦状)に腐蝕された第一凹部45形成面側からリードフレーム材料41をエッチングし、露出させ、インナーリード先端部49を形成した。(図4(d))

この際、インナーリード先端部のエッチング形成面49Sはインナーリード側にへこんだ凹状になる。また、先の第1回目のエッチング加工にて作製された、エッチング形成面49Sを挟む2面もインナーリード側にへこんだ凹状である。次いで、洗浄、エッチング抵抗層48の除去、レジスト膜(レジストパターン42A、42B)の除去を行い、インナーリード先端部49が微細加工された図4(a)に示すリードフレームを得た。エッチング抵抗層48とレジスト膜(レジストパターン42A、42B)の除去は水酸化ナトリウム水溶液により溶解除去した。

【0013】尚、上記実施例においては、エッチング加工にて、図3(a)に示ように、インナーリード先端部から導体部15を延長し、インナーリード先端部同士を繋げた形状にして形成したものを得て、導体部15をプレス等により切断除去して図1(a)に示す形状を得る。図3(a)に示すものを切断し、図1に示す形状にする際には、図3(b)に示すように、通常、補強のためポリイミドテープを使用する。図3(b)の状態では、プレス等により導体部15を切断除去し、図2(a)、図2(b)に示すように半導体素子20をインナーリード先端部11Aにバンパ21を介して搭載した後、図6(a)に示すワイヤボンディング接続のものと同様に、樹脂封止をするが、半導体素子は、テープをつけた状態のまま、図3(b)のように搭載され、そのまま樹脂封止される。

【0014】尚、本発明によるインナーリード先端部49の微細加工は、第二凹部46の形状と、最終的に得られるインナーリード先端部の厚さに左右されるもので、例えば、板厚1を50μmまで薄くすると、図4(e)に示す、平坦幅Wを100μmとして、インナーリード先端部チップ49の、1.5mmまで微細加工可能となる。板厚1を300μm程度まで薄くし、平坦幅Wを700μm程度とすると、インナーリード先端部チップ49の、1.5mm程度まで微細加工可能となる。板厚1を1mm程度とすると、インナーリード先端部チップ49の、1.5mm程度まで微細加工可能となる。

これは更に狭いピッチまで作製が可能となる。

【0015】

【発明の効果】本発明のリードフレームは、上記のように、半導体素子をバンパを介してインナーリード先端部に搭載する、樹脂封止型半導体装置に用いられるリードフレームにおいて、バンパとバンパを搭載するインナーリード先端部との位置ズレが起きても、電気的接続がしやすいものの提供を可能とするものであり、且つ、エッチング加工にてインナーリード先端部の微細加工が可能で製造している。又、本発明のリードフレームの製造方法は、半導体装置の多端子化に伴う、リードフレームのインナーリード先端部の小ピッチ化、微細化に対応でき、且つ、半導体装置作製のためのアセンブリ工程や実装工程等の後工程にも対応できる。上記本発明のリードフレームの製造を可能とするものである。結局、本発明は、半導体装置用のリードフレームで、半導体装置の多端子化対応でき、且つ、半導体装置作製の後工程にも対応できる、高精細なリードフレームを提供することを可能としている。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例のリードフレーム、

【図2】実施例のリードフレームを説明するための図

【図3】エッチング後のリードフレームの形状等を説明するための図

【図4】本発明実施例のリードフレームの製造工程図

【図5】従来のリードフレームのエッチング製造工程を説明するための図

【図6】樹脂封止型半導体装置図

【図7】従来のフリップチップ法を説明するための図

【符号の説明】

10	リードフレーム
11	インナーリード
11A	インナーリード先端部
12	アウターリード
13	ダムバー
14	フレーム部
15	導体
16	テープ
20、20a	半導体素子
21、21a	バンパ
25、25a	テープ
11	リードフレーム素材
12A、12B	レジストパターン
13	第一凹部
14	第二凹部
15	第一凹部
16	第二凹部
17	平坦面
18	エッチング抵抗層
	インナーリード先端部

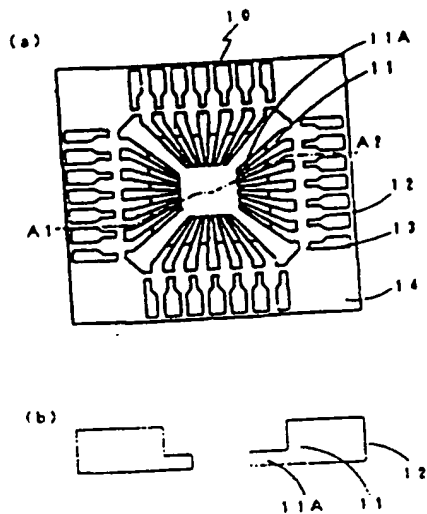
(7)

12

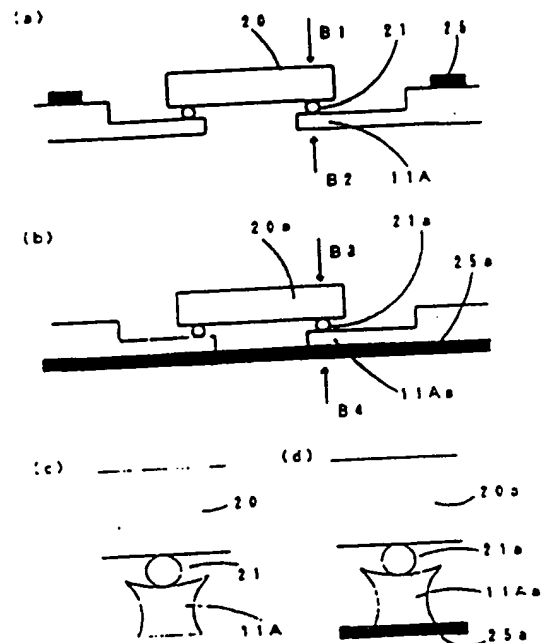
- 51 リードフレーム素材
 52 フォトリソグ
 53 レジストパターン
 54 インナーリード
 60, 60a 樹脂封止型半導体装置
 61, 61a 半導体素子
 62 ダンパッド
 63, 63a インナーリード
 63aA インナーリード先端部
 64, 64a アウターリード

- 65, 65a 図形
 66 半導体素子電極部
 67 ワイヤ
 67a パンパ
 70 半導体素子
 71 パンパ
 72 配線 (インナーリード)
 72A 電極部 (インナーリード先
 端部)
 10 73 セラミック基板

[1A]

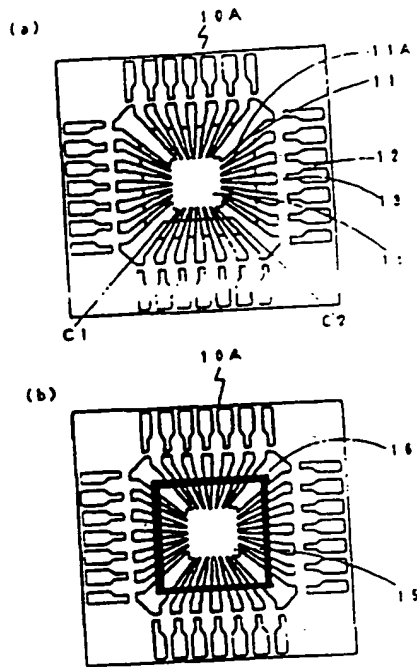


[1A']

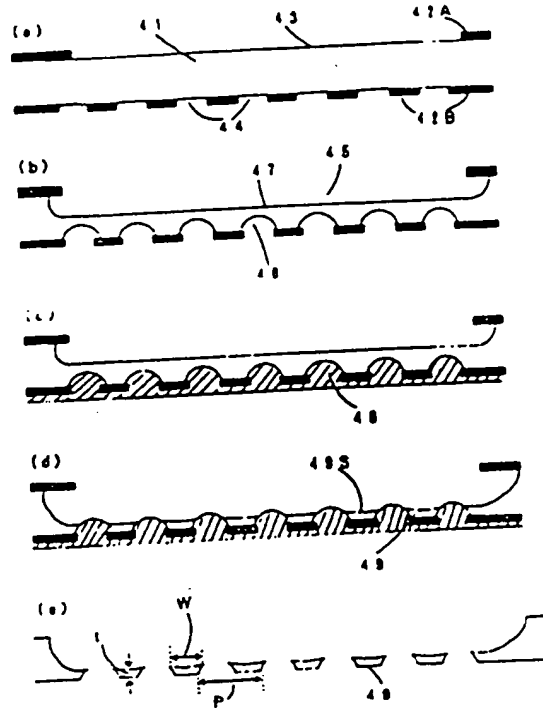


(8)

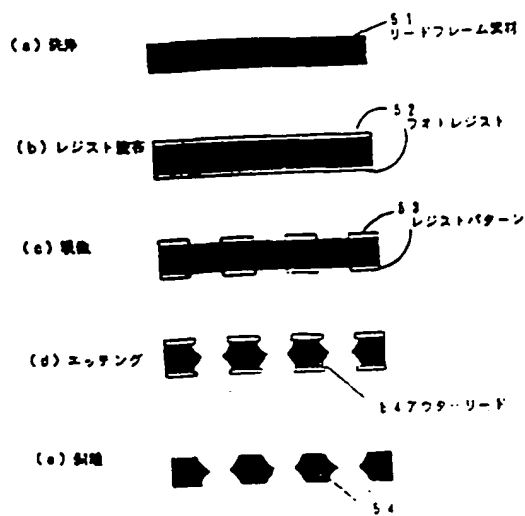
【図3】



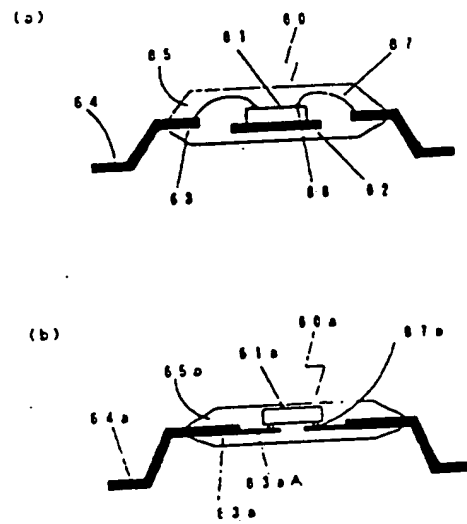
【図4】



【図5】



【図6】



(9)

(147)

